

特点

- 全扩散工艺
- 平板型陶瓷管封装
- 双面冷却

典型应用

- 大功率变流器
- 焊接设备
- 电机控制和驱动
- 充电设备

| | |
|-------------------|------------------|
| $I_{F(AV)}$ | 3500A |
| V_{DRM}/V_{RRM} | 100-5000V |
| I_{FSM} | 60KA |
| I^2t | 21780 10^3a^2s |

| 符号 | 参数 | 测试条件 | 结温 $T_J(^{\circ}C)$ | 参数值 | | | 单位 |
|---------------|------------|--|------------------------|-----|----|-------|------------------|
| | | | | 最小 | 典型 | 最大 | |
| $I_{F(AV)}$ | 正向平均电流 | 180° 正弦半波, 50HZ 双面散热, THS=126°C | 150 | | | 3500 | A |
| $I_{T(RMS)}$ | 方均根电流 | 180° 正弦半波, 50HZ 双面散热, THS=55°C | 150 | | | 5916 | A |
| V_{RRM} | 反向重复峰值电压 | $V_{DRM}\&V_{RRM} tp=10ms$ $V_{DSM}\&V_{RSM}=V_{DRM}\&V_{RRM}+100V$ | 150 | 100 | | 5000 | V |
| I_{RRM} | 反向重复峰值电流 | $V_{RM}=V_{RRM}$ | 150 | | | 200 | mA |
| I_{FSM} | 正向不重复浪涌电流 | 10ms 底宽, 正弦半波 | 150 | | | 60 | KA |
| I^2t | 浪涌电流平方时间积 | $V_R=0.6V_{RRM}$ | | | | 2178 | $A^{2S}\cdot 10$ |
| V_{TO} | 门槛电压 | | 150 | | | 0.85 | V |
| r_T | 斜率电阻 | | | | | 0.069 | $m\Omega$ |
| V_{FM} | 通态峰值电压 | $I_{TM}=5000A, F=9.0KN$ | 150 | | | 2.0 | V |
| I_{rm} | 反向恢复电流 | $I_{TM}=5000A, tq=1000us$ $Di/dt=-20A/us.$ $V_r=50V$ | 150 | | | 150 | A |
| t_{rr} | 反向恢复时间 | | | | | 8.0 | us |
| Q_{rr} | 恢复电荷 | | | | | 600 | uC |
| $R_{th(j-h)}$ | 热阻抗(结至散热器) | 180° 正弦波, 双面散热 压紧力 15KN | | | | 0.011 | $^{\circ}C/W$ |
| F_M | 安装力 | | | 35 | | 47 | KN |
| T_{stq} | 储存温度 | | | -40 | | 175 | $^{\circ}C$ |
| W_t | 质量 | | | | | | g |
| Outline | 外形 | | | | | | |

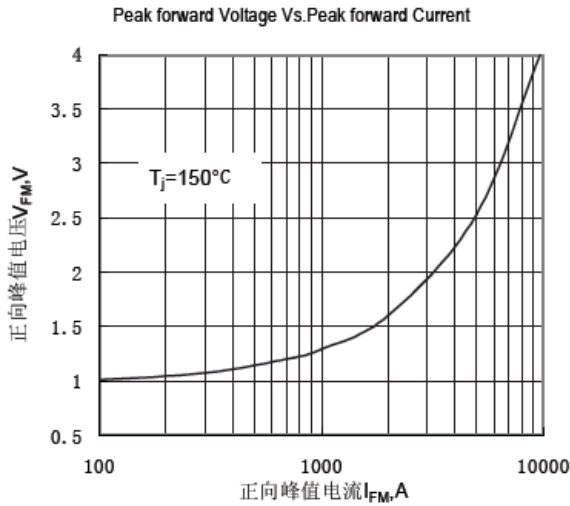


Fig.1 通态伏安特性曲线

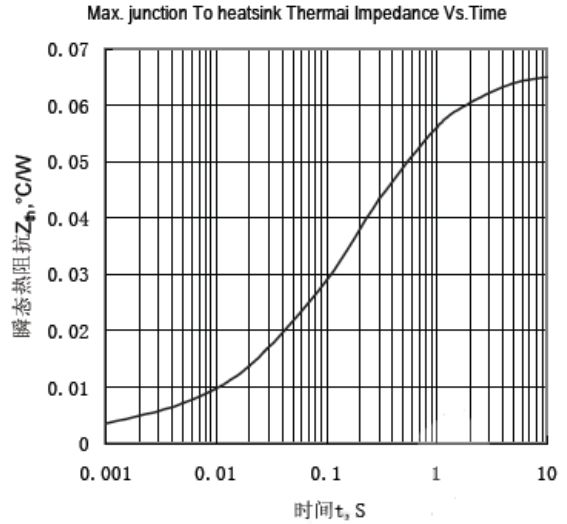


Fig.2 结至散热器瞬态热阻抗曲线

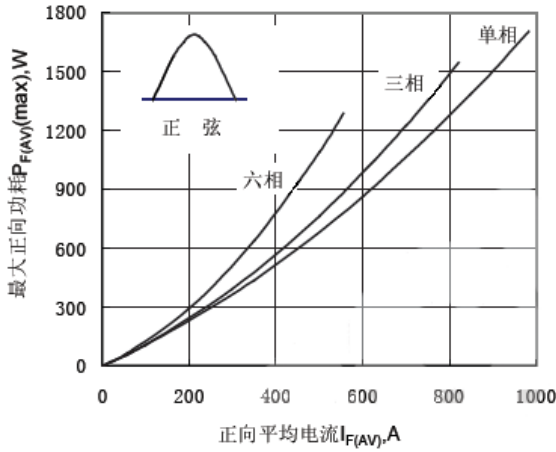


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

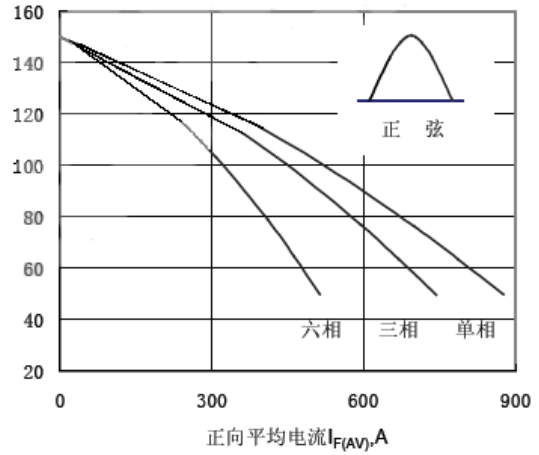


Fig.4 散热器温度与通态平均电流关系曲线

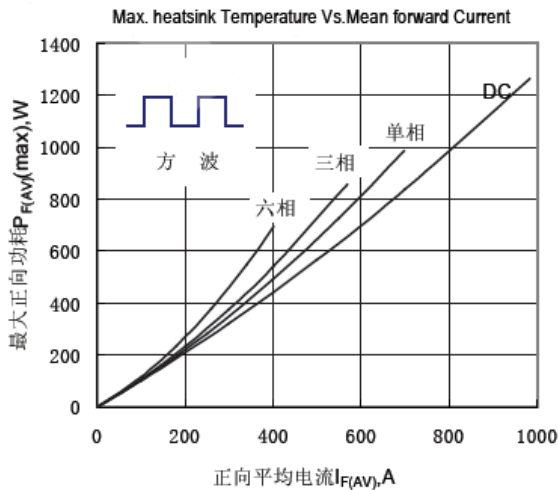


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

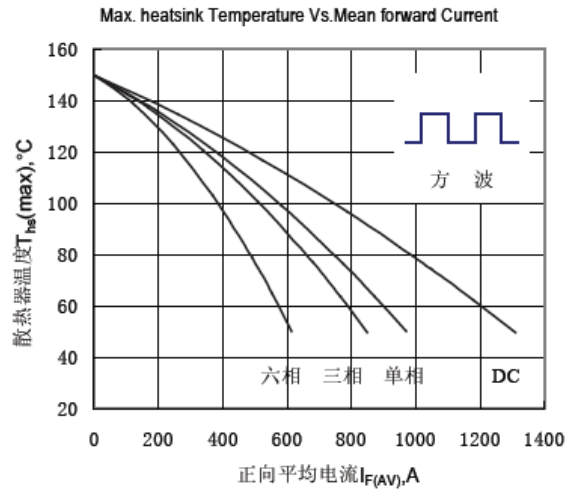


Fig.6 散热器温度与通态平均电流关系曲线

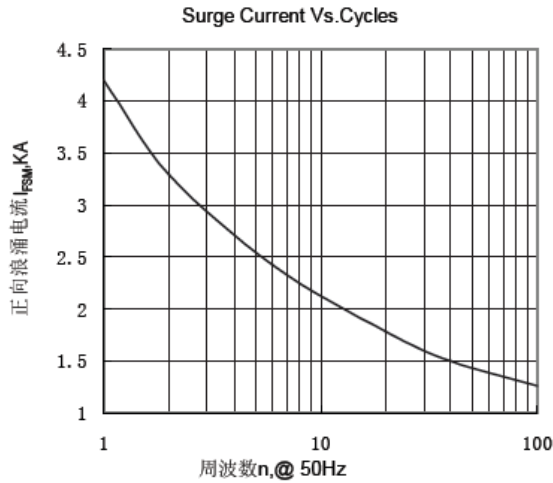


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

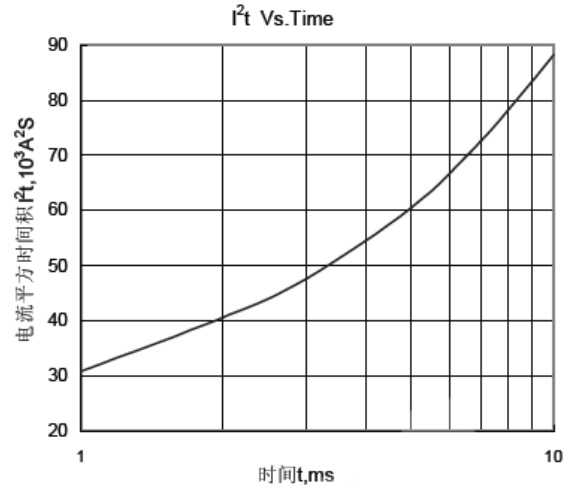


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形图:

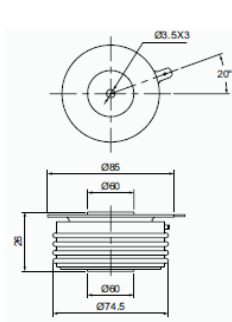


图 1

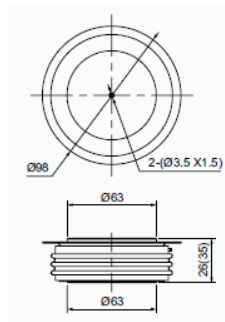


图 2

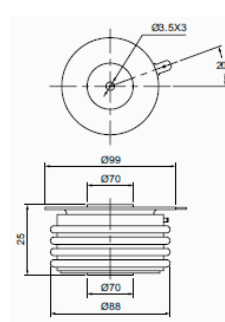


图 3

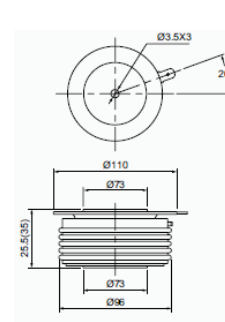


图 4